めっき欠陥

## 1-8-2-3 糊付着短絡/胶迹的短路/ Short by adhered adhesive

【特徴】銅めっき面の糊状短絡

【特征】镀铜面有胶迹的短路。

**[Characteristics]** Short on the plated copper surface caused by adhesive residue

【原因・判断ポイント・発生工程】 DFR ラミネート前の銅めっき表面に付着した糊が ET レジストとなった為出来たもの(DFRラミネート前~ET工程)

【原因、判断要点、发生工序】在 DFR 压合前,镀铜层的胶迹成为 ET 剂而引起的 (DFR 压合前~ ET 工序)。

### [Causes/processes involved/keys to judgment]

Adhesive adhered on plated copper surface before dry film lamination acts an etching resist causing the defect. (Before dry film lamination - etching process)



顕微鏡倍率× 100

注释】

显微镜倍率 × 100

[Coments]

Magnification: ×100



【コメント】 顕微鏡倍率× 100 【注释】

显微镜倍率 × 100

[Coments]

Magnification: ×100

# 1-8-3 露光被り短絡/妨碍曝光的短路/Caused by photographic fogging

# 1-8-3-1 AWF 下異物短絡/在 AWF 下面有杂物的短路 / Short by a foreign object under a phototool

【特徴】対面する導体の両側から突起状に出た頂点 で繋がった形の短絡

【特征】导线的两侧凸出,顶点相接的短路。

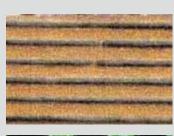
**[Characteristics]** Short caused by conductor projections protruding from both of conductors facing each other and connecting at their tips.

【原因・判断ポイント・発生工程】ネガタイプAWFの不透明部下の導体間隔部に異物が介在し、AWFが浮き上った為露光被りして出来たもの(露光焼付~ET工程)

【原因、判断要点、发生工序】在 AWF 不透明下面的导线间夹杂杂物,导致 AWF 隆起,妨碍曝光而引起的(曝光~ET工序)。

#### [Causes/processes involved/keys to judgment]

Photographic fogging caused by lift-up of a negative pattern phototool at the opaque area between conductors by a foreign object forms the defect. (Imaging - etching process)



【コメント】 顕微鏡倍率×

显微镜倍率 ×
[Coments]
Magnification: ×



「コメント】 FPC FPC 顕微鏡倍率× 「注释」 FPC 显微镜倍率×

FPC Magnification: ×

[Coments]